

# 2019年3月期 第1四半期（2018年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2018年7月26日

内容：

- 第1四半期 連結決算の概要
- 事業環境および業績予想

経理部長

代表取締役社長・CEO

笹川 謙

河合 利樹



# 将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ

# 第1四半期 連結決算の概要

2018年7月26日

笹川 謙  
経理部長



## FY2019 Q1（2018年4月～6月）ハイライト

- Q1業績は上期計画に沿って順調に進捗
  - Q2新規装置売上計画のうち、SPEは6割以上、FPDはすべて出荷済み
- SPE\*売上は、データセンタ需要の高まりを背景に、高水準継続
- FPD\*\*では第10.5世代への投資継続

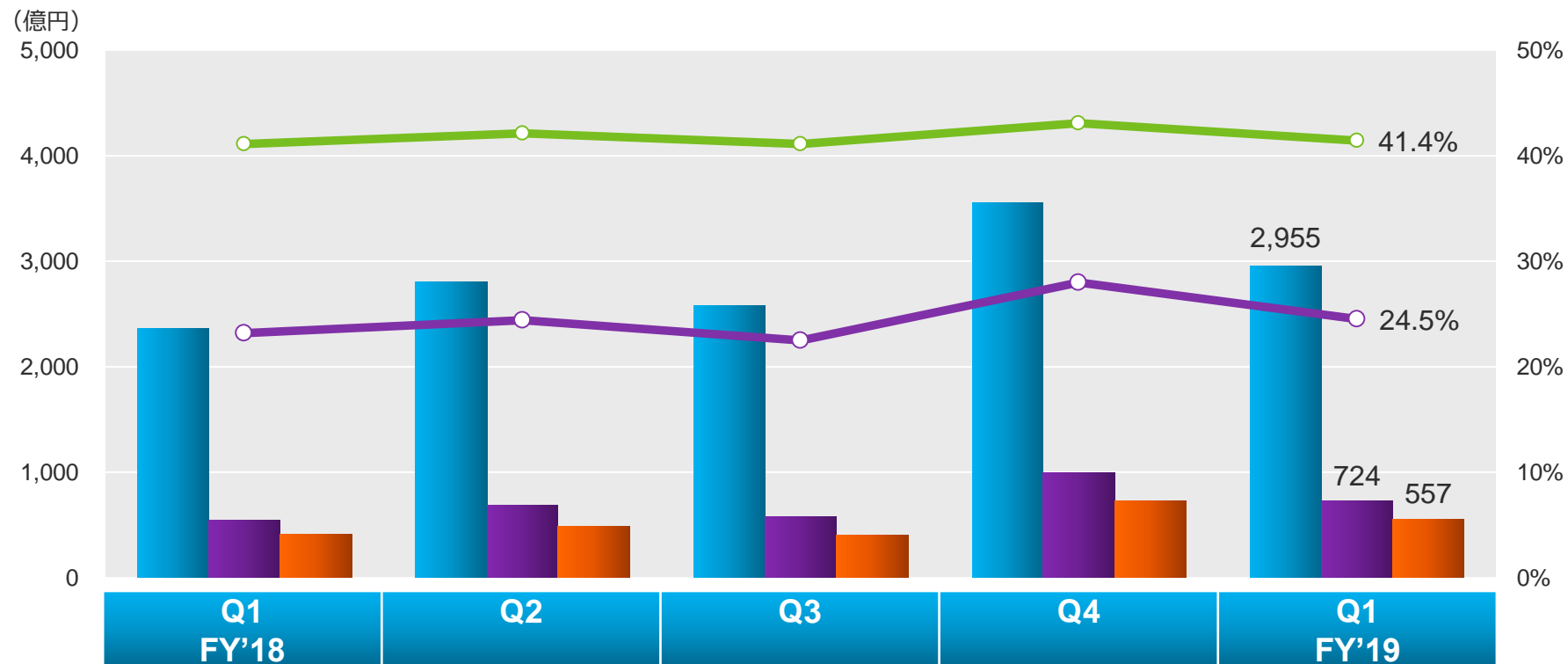
# 損益状況

(億円)

	FY2018				FY2019	対前年Q4 増減率
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	
売上高	2,363	2,805	2,577	3,559	2,955	-17.0%
SPE	2,219	2,657	2,414	3,260	2,804	-14.0%
FPD	143	147	162	297	151	-49.2%
売上総利益	971	1,182	1,060	1,535	1,224	-20.2%
下段：売上総利益率	41.1%	42.1%	41.1%	43.1%	41.4%	-1.7pts
販管費	423	497	479	537	500	-6.9%
営業利益	547	685	580	997	724	-27.4%
下段：営業利益率	23.2%	24.4%	22.5%	28.0%	24.5%	-3.5pts
税金等調整前当期純利益	551	671	573	956	752	-21.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	412	494	407	729	557	-23.6%
研究開発費	211	248	239	270	261	-3.5%
設備投資額	81	117	137	120	96	-19.3%
減価償却費	42	47	55	60	50	-16.6%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。  
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

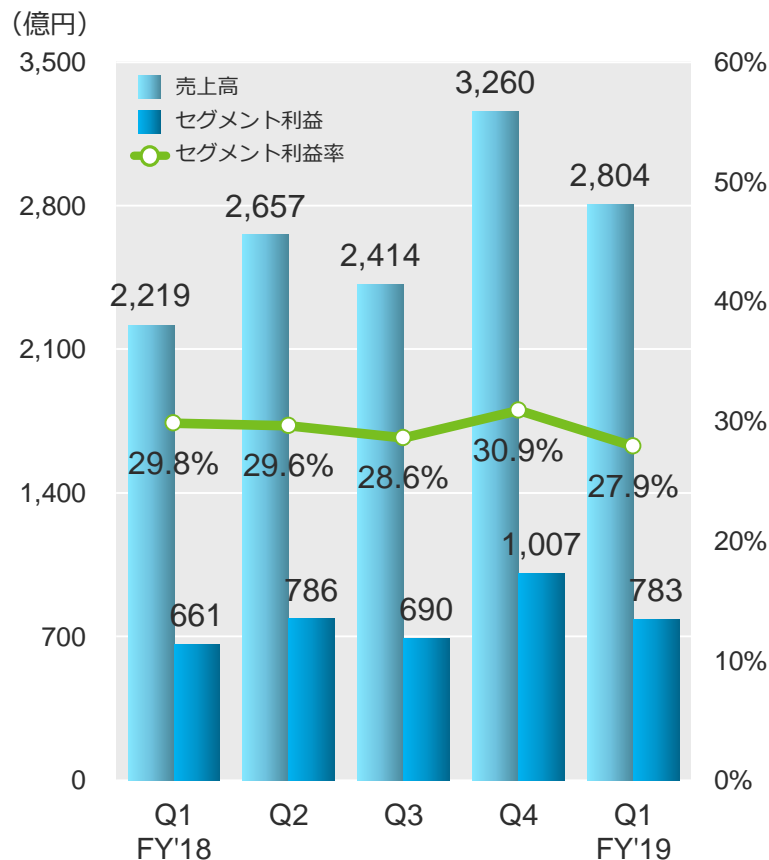
# 損益状況



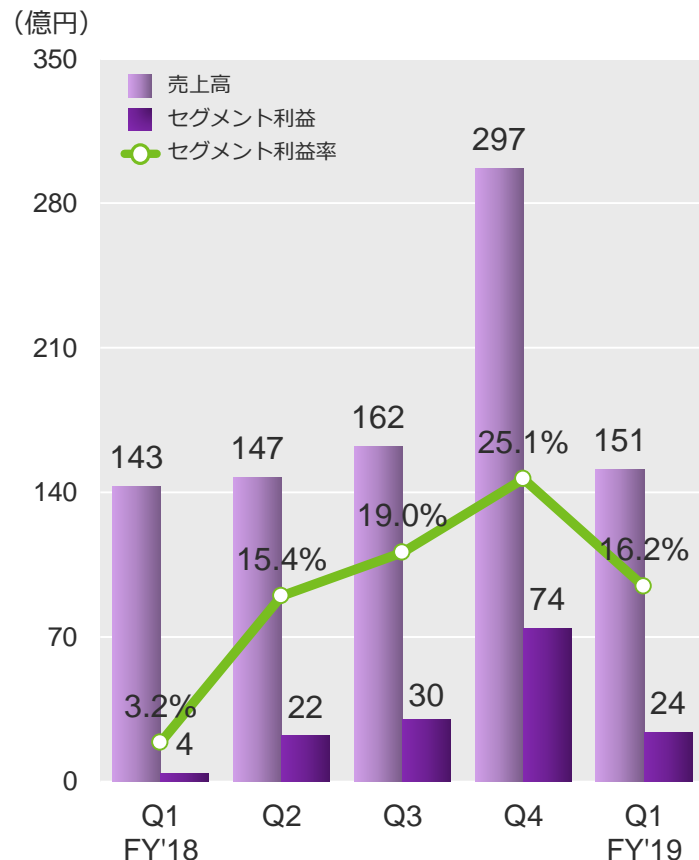
■ 売上高	2,363	2,805	2,577	3,559	2,955
■ 営業利益	547	685	580	997	724
■ 親会社株主に帰属する当期純利益	412	494	407	729	557
○ 売上総利益率	41.1%	42.1%	41.1%	43.1%	41.4%
○ 営業利益率	23.2%	24.4%	22.5%	28.0%	24.5%

# セグメント情報

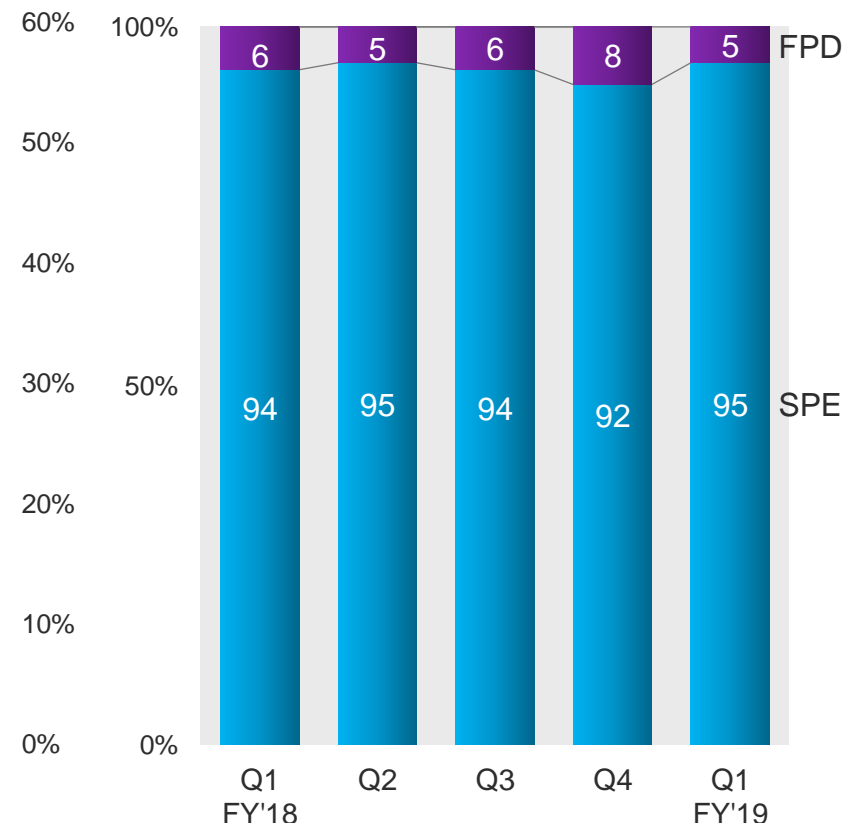
## SPE (半導体製造装置)



## FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

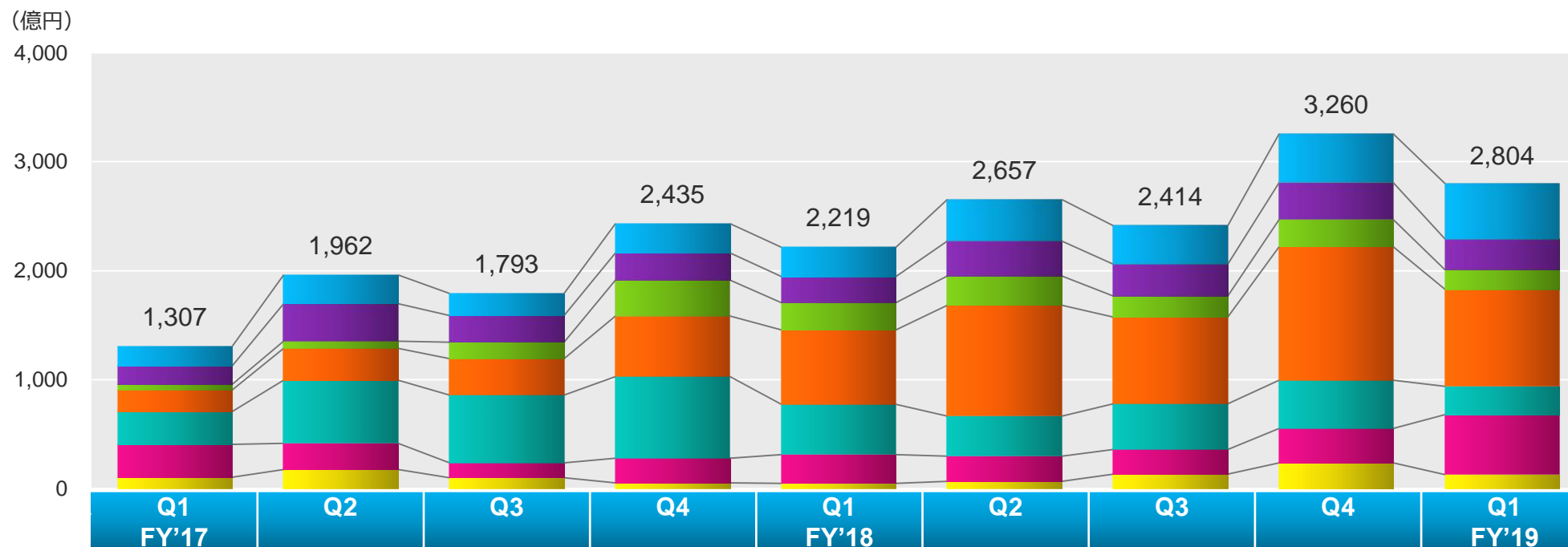


## 売上構成比率



1. セグメント利益は、税金等調整前当期純利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究または要素研究等の研究開発費、およびその他の一般管理費等があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

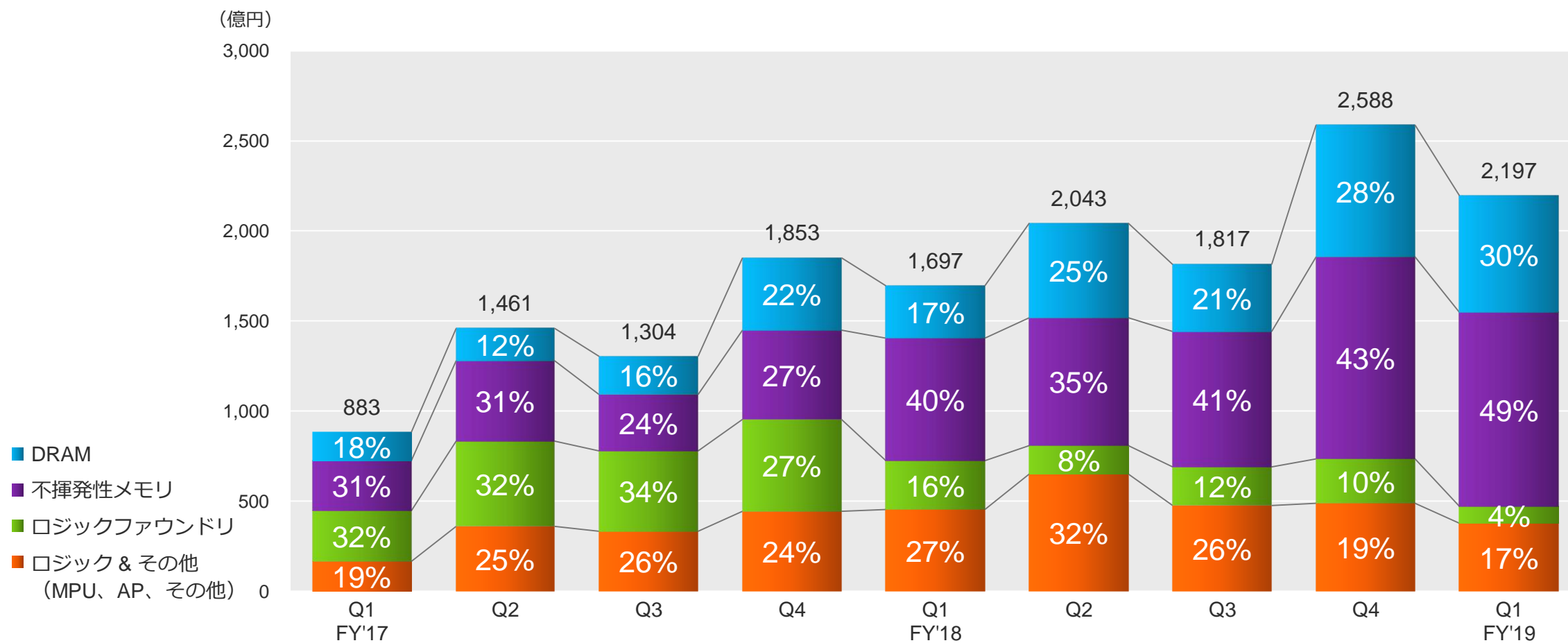
# SPE部門 地域別売上高



	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19
■ 日本	178	264	203	266	267	384	351	451	511
■ 北米	170	344	246	254	240	320	291	339	284
■ 欧州	52	66	150	329	253	269	196	250	177
■ 韓国	198	290	333	555	683	1,017	794	1,223	889
■ 台湾	305	582	623	747	458	366	421	443	263
■ 中国	300	240	137	227	267	230	226	318	549
■ 東南アジア・他	103	173	98	53	46	67	132	234	127



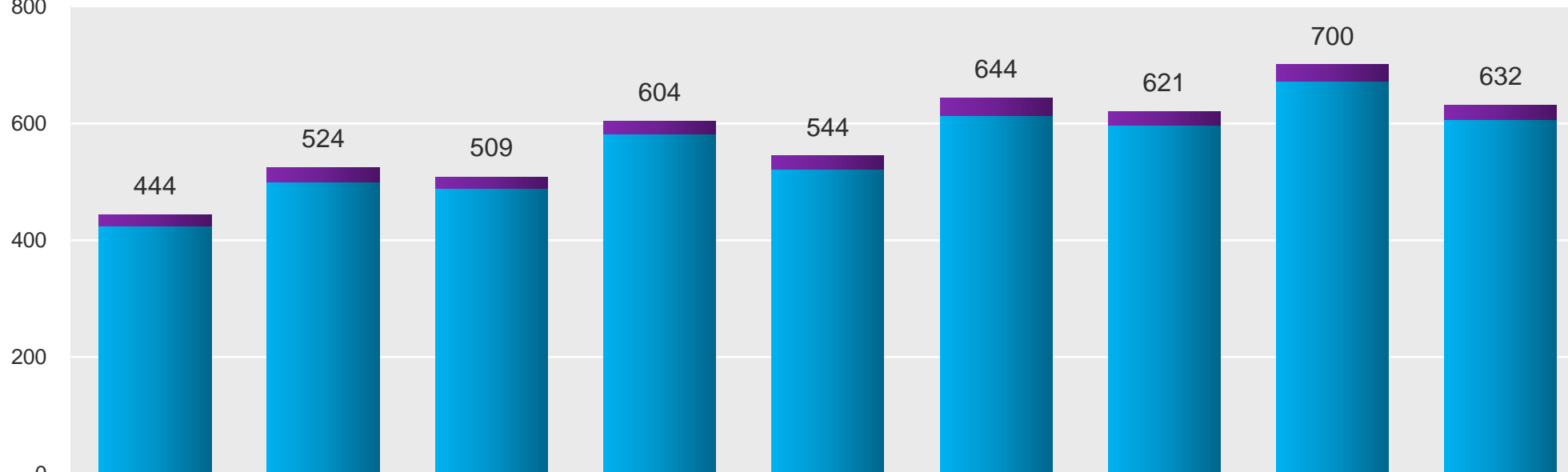
# SPE部門 新規装置 アプリケーション別売上構成比



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。

# フィールドソリューション売上高

(億円)

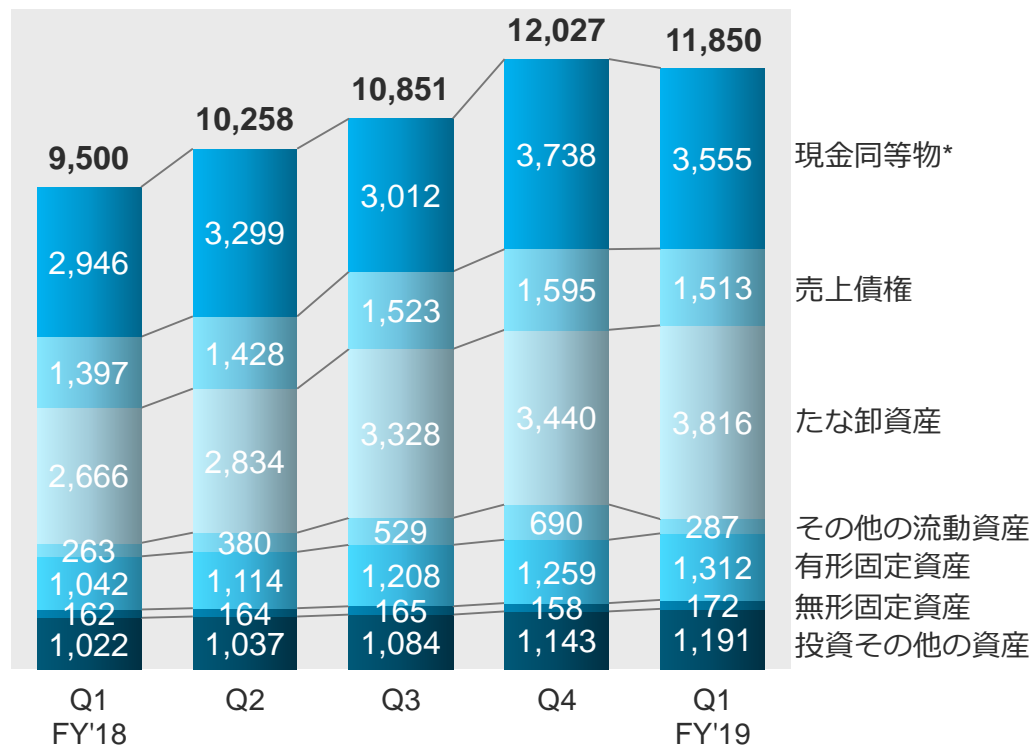


	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19
■ SPE売上高	424	500	488	581	522	614	597	672	606
■ FPD売上高	20	24	20	22	22	29	24	28	25

# 貸借対照表

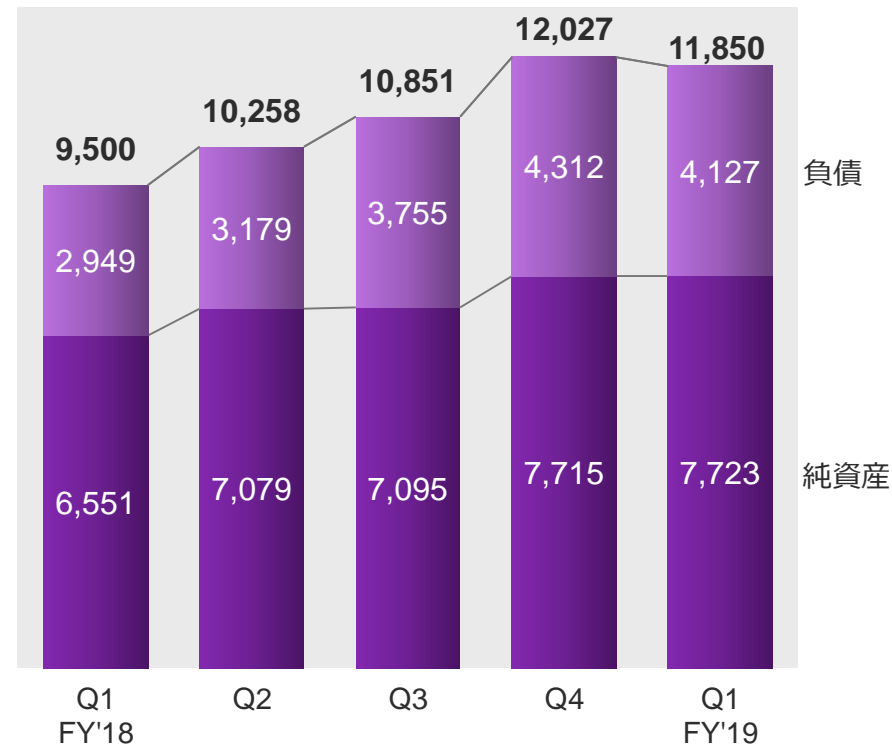
## 資産

(億円)



## 負債・純資産

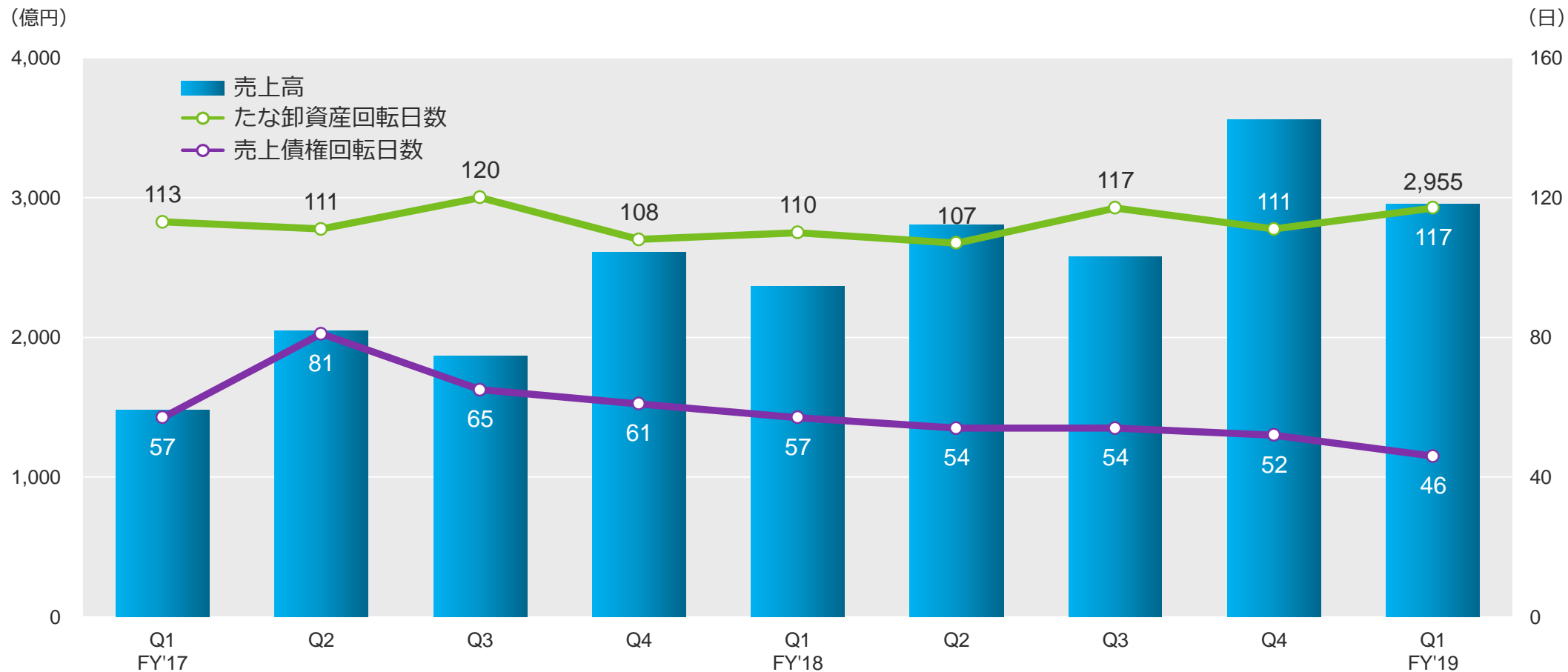
(億円)



\* 現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等をFY2019 Q1会計期間の期首から適用しており、FY2018の実績については当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しています。

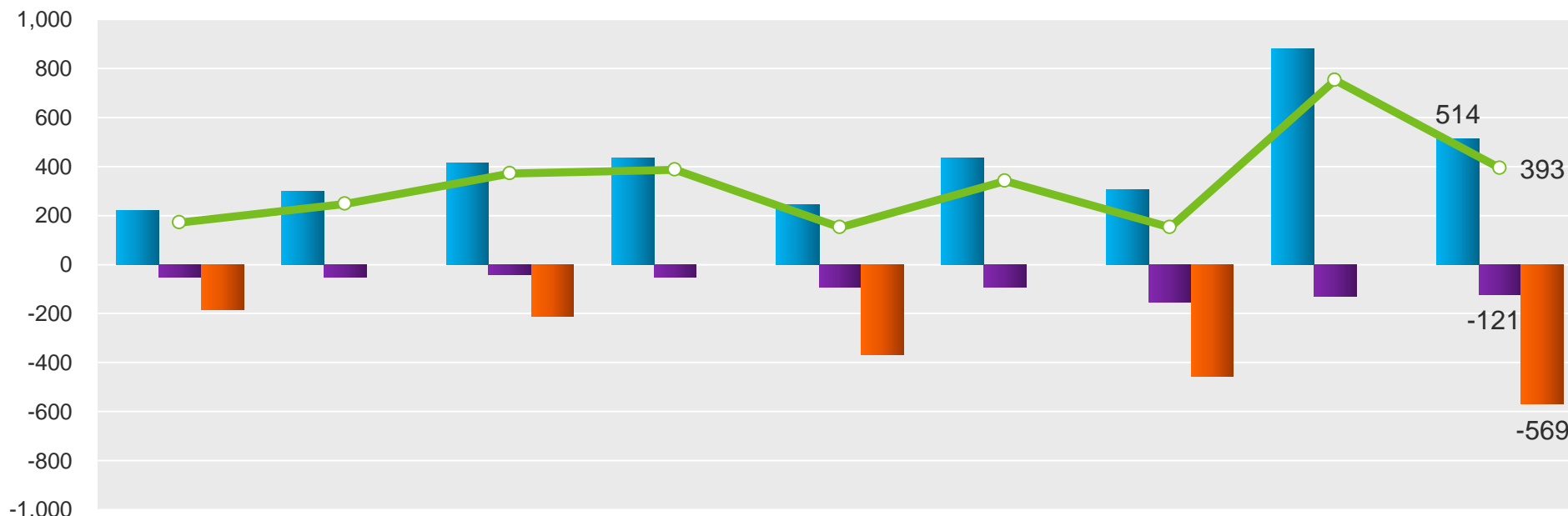
# たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

# キャッシュ・フロー

(億円)



	Q1 FY'17	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'18	Q2	Q3	Q4	Q1 FY'19
■ 営業キャッシュ・フロー	221	298	413	436	244	434	304	881	514
■ 投資キャッシュ・フロー*	-49	-49	-41	-49	-93	-94	-152	-128	-121
■ 財務キャッシュ・フロー	-183	0	-210	-0	-368	-0	-457	-0	-569
○ フリーキャッシュ・フロー**	172	248	371	387	151	340	151	753	393
手元資金残高***	2,309	2,556	2,772	3,153	2,946	3,299	3,012	3,738	3,555

\* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

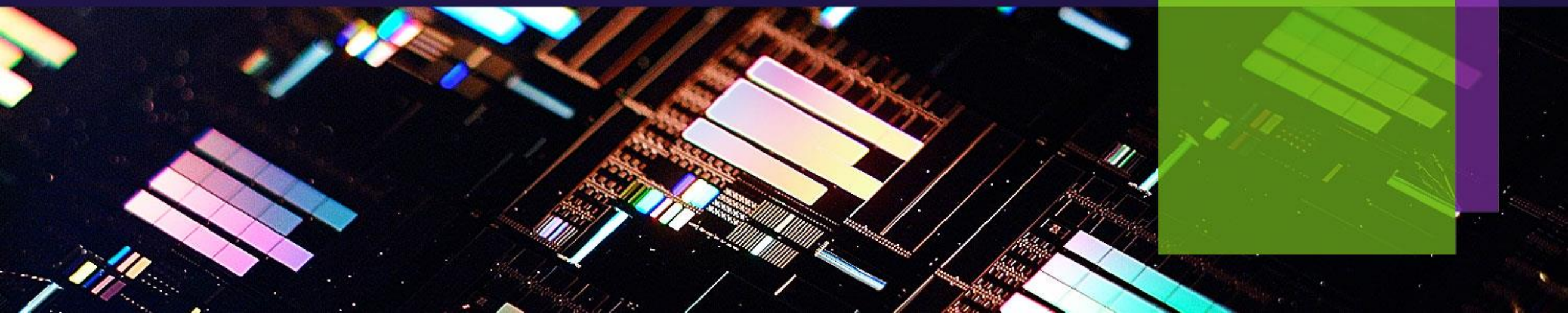
\*\* フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

\*\*\* 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

# 事業環境および業績予想

2018年7月26日

河合 利樹  
代表取締役社長・CEO



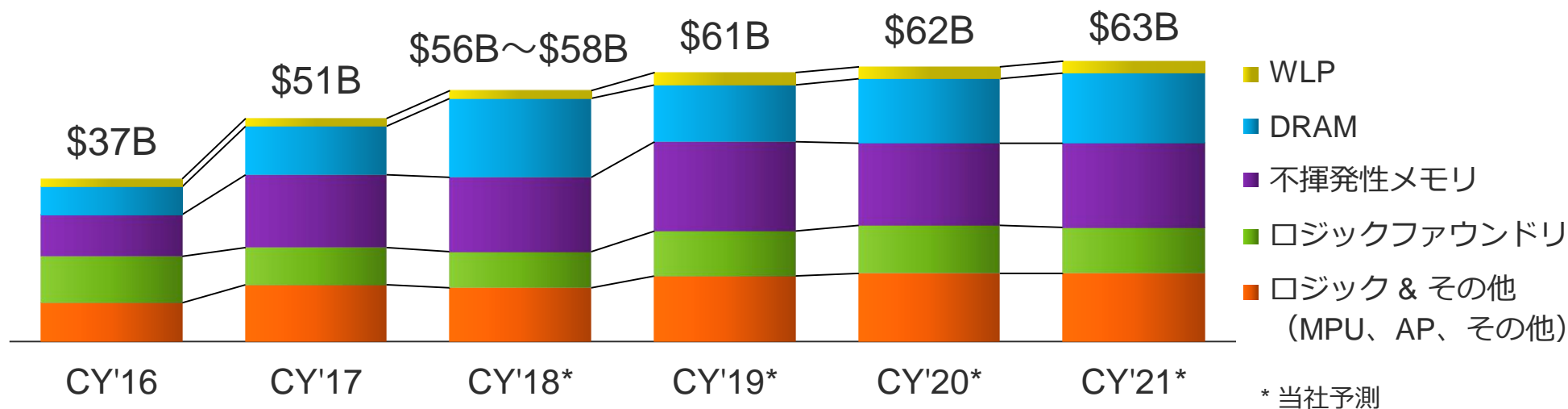
# 半導体前工程製造装置(WFE)市場の展望

## 将来の成長ドライバー

PC・インターネット・モバイル  
+  
VR/AR/MR\*・IoT・AI・RPA\*\*・機械学習  
ビッグデータ・自動運転・ブロックチェーン

WFE市場の成長加速  
\$60B以上へ拡大

\*VR/AR/MR：仮想現実/拡張現実/複合現実 \*\*RPA：ロボットによる処理自動化



半導体用途の広がりにより、装置市場は一段上のフェーズへ

## 事業環境（2018年7月時点での見方）

### ▶ 半導体前工程製造装置(WFE)\* の設備投資

CY2018の投資額は、旺盛なメモリ向け需要に牽引され、前年比10～15%程度の成長を見込む

### ▶ FPD製造装置 TFTアレイ工程\*\* 向け設備投資

CY2018の装置需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資は調整も、第10.5世代向けが大きく拡大し、前年同等の高水準の投資が継続

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が継続

\* 半導体前工程製造装置（WFE; Wafer fab equipment）：半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程があります。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置です。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含んでいます。

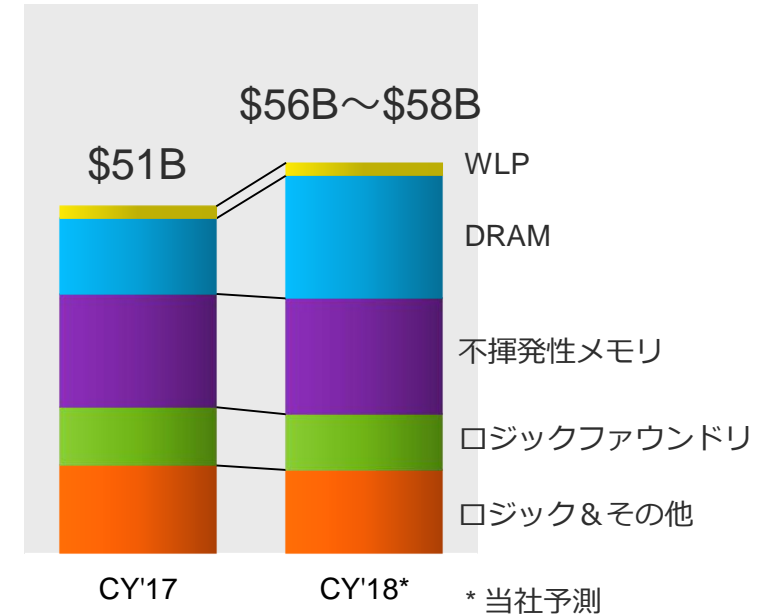
\*\* TFTアレイ工程：ディスプレイを駆動する電気回路機能を持つ基板を製造する工程



# CY2018 アプリケーション別のWFE市場と事業機会

- DRAM：前年比60～65%増加
  - 設備投資：投資額の7割が新規工場向け、また8割が1X/1Ynm世代向け
  - 牽引役：サーバの平均搭載容量は前年比35%増加
  - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- 不揮発性メモリ：前年同水準～5%増加
  - 設備投資：最先端の9X層数世代向けが5割
  - 牽引役：データセンタ・PC向けSSD需要の拡大
  - 事業機会：高付加価値のエッチング・洗浄工程で差別化
- ロジック/ファウンドリ：前年比10%減少～同水準
  - 設備投資：10nm以細の世代向けが5割
  - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
  - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

アプリケーション別WFE市場



# FY2019 事業進捗

- SPEの事業戦略は計画通り進捗
  - 注力分野（エッチング、成膜、洗浄）において、POR\*の獲得が進む
  - IoTアプリケーションの拡大と納入済み装置台数の増加により、FS事業も好調
- FPD製造装置の収益性向上が計画通り進む
  - PICP™ エッチング装置の第8.5世代への展開
  - 第10.5世代向け売上増加
- 宮城工場（エッチング装置）の拡張
  - 新物流棟における自動倉庫システムの運用開始（6月）
  - 新開発棟の竣工（9月予定）
  - 新生産ラインの稼働（11月予定）



東京エレクトロン宮城

# FY2019 業績予想

# FY2019 業績予想 (2018/4/25発表から変更なし)

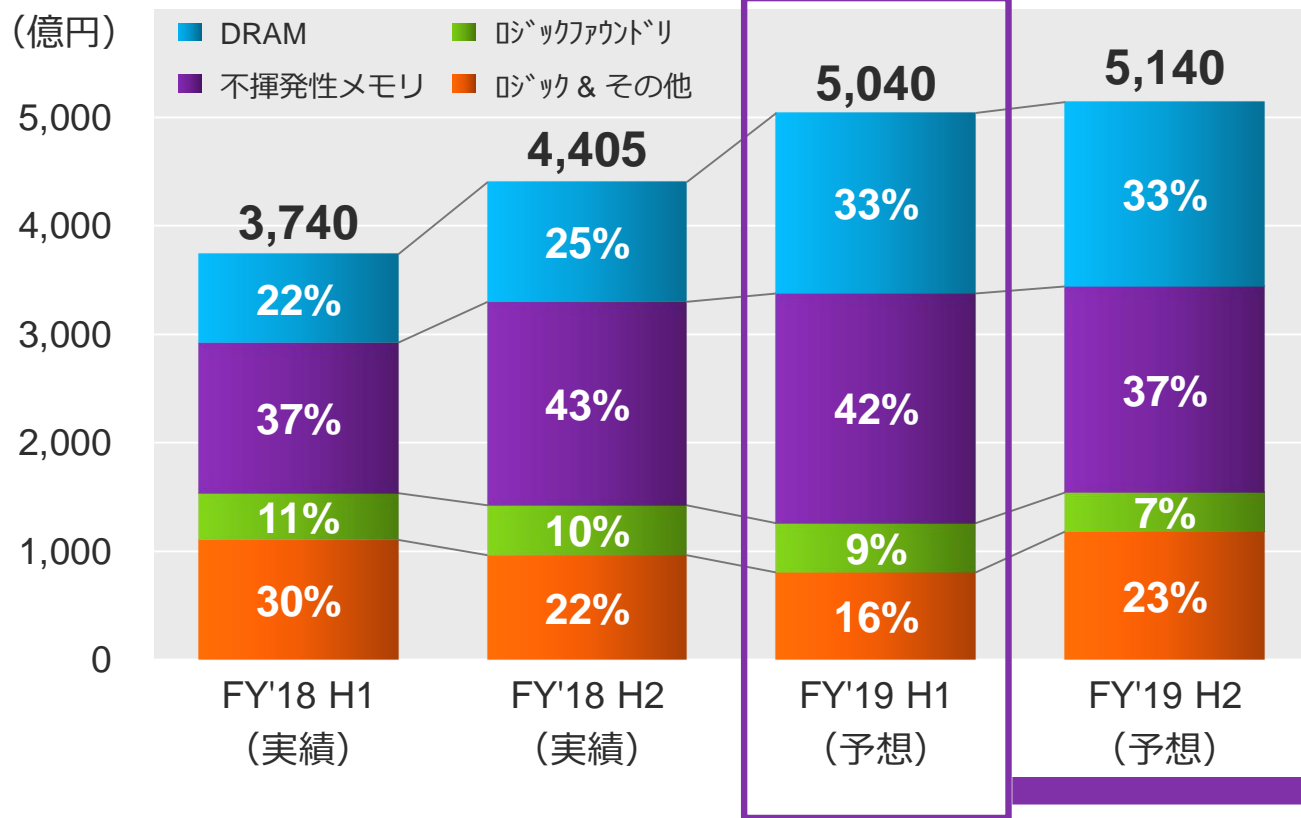
(億円)

	FY2018 (実績)	FY2019 (予想)			
		H1	H2	通期	通期 対前年増減
売上高	11,307	6,900	7,100	14,000	+23.8%
SPE	10,552	6,340	6,540	12,880	+22.1%
FPD	750	560	560	1,120	+49.2%
売上総利益	4,750	2,880	3,100	5,980	+1,229
下段：売上総利益率	42.0%	41.7%	43.7%	42.7%	+0.7pts
販管費	1,938	1,150	1,170	2,320	+381
営業利益	2,811	1,730	1,930	3,660	+848
下段：営業利益率	24.9%	25.1%	27.2%	26.1%	+1.2pts
税金等調整前当期純利益	2,752	1,730	1,930	3,660	+907
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,043	1,280	1,420	2,700	+656
1株当たり当期純利益 (円)	1,245.48	779.95	-	1,645.20	+399.72

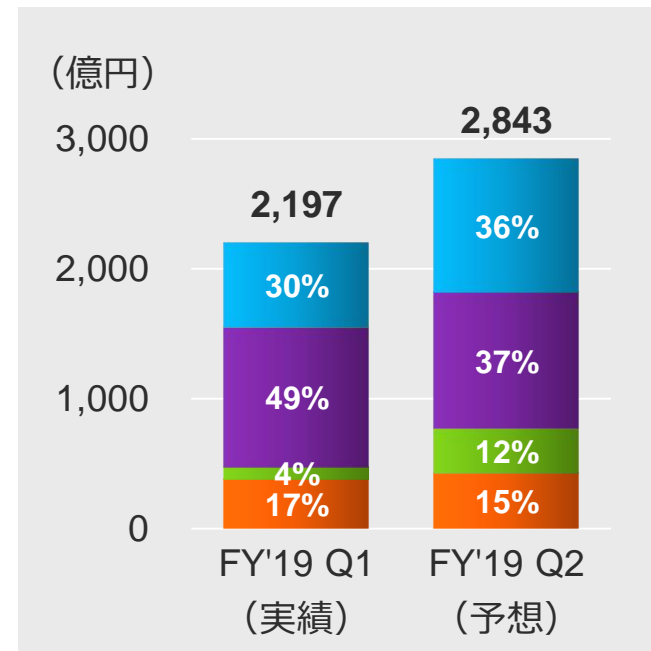
市場成長以上の売上拡大、3期連続の過去最高益\*を見込む

# FY2019 SPE部門 新規装置売上予想

アプリケーション別売上構成比



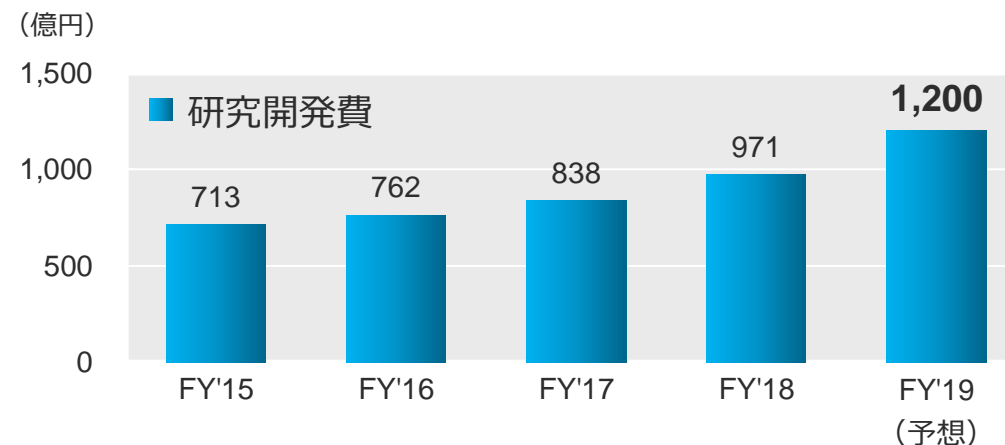
グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高を含んでいません。



Q1実績は計画通り、Q2売上計画の6割以上が出荷済み  
今後も高水準のメモリ向け投資が継続

# FY2019 研究開発費・設備投資計画 (2018/4/25発表から変更なし)

- 開発費 1,200億円
  - 注力分野および持続的成長を見据えた投資継続
- 設備投資 510億円
  - 先端技術開発・増産対応への積極的な投資
- 減価償却費 260億円



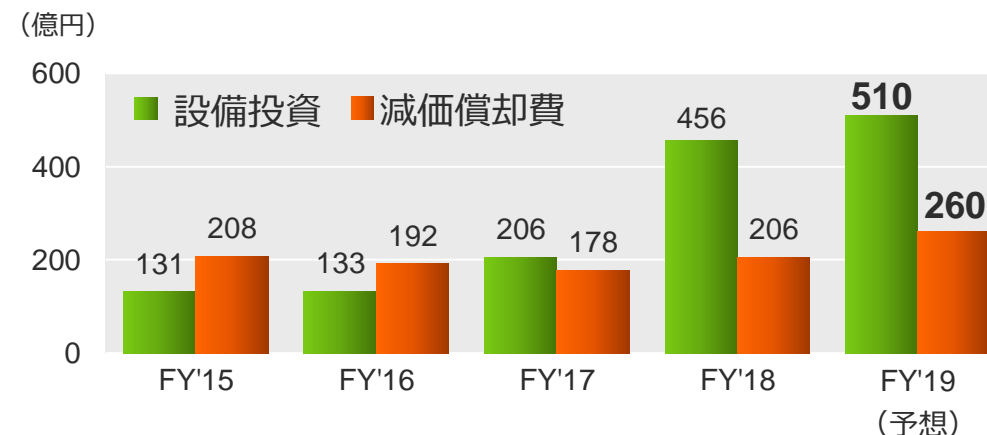
新生産棟の建設  
(成膜装置・ガスケミカルエッチング装置・テストシステム)



山梨県富士吉田市：建設費約130億円  
(2019年1月着工、2020年4月竣工予定)

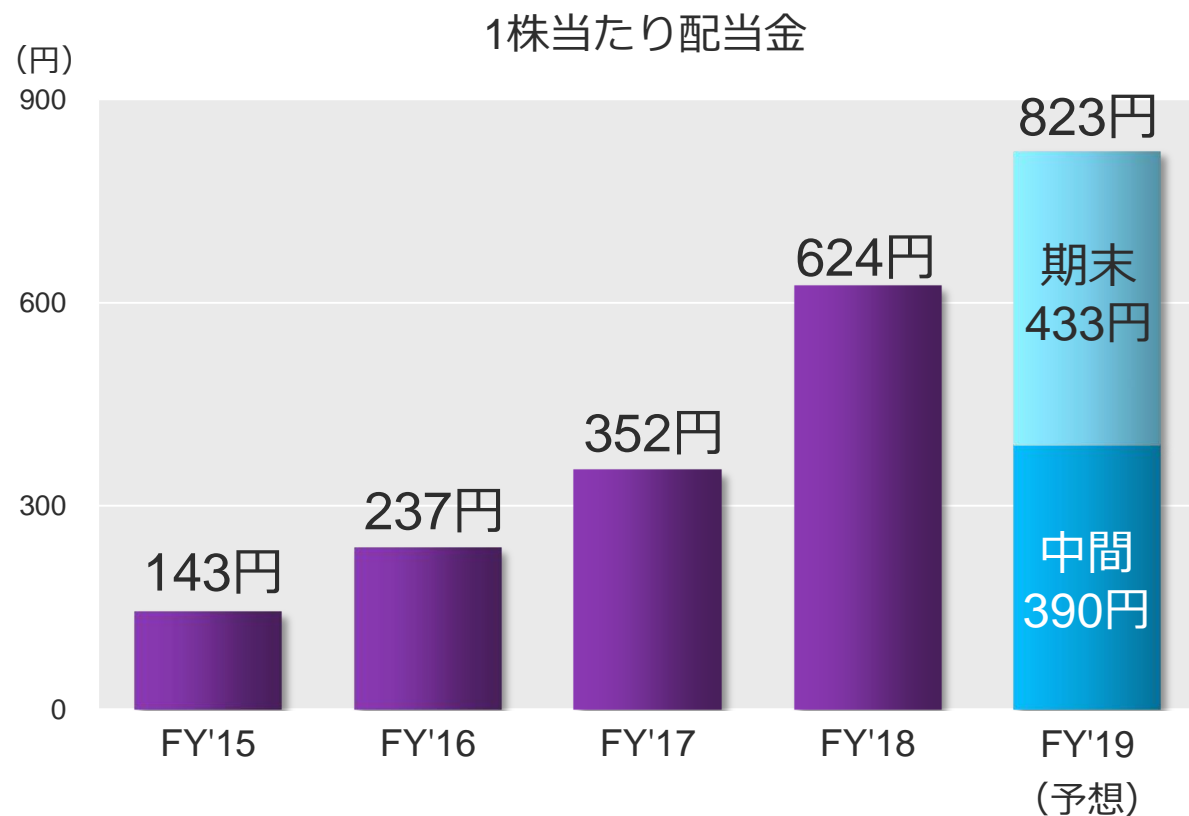


岩手県奥州市：建設費約130億円  
(2018年10月着工、2019年9月竣工予定)



## 成長フェーズにある装置市場で事業機会を最大化

# FY2019 配当予想 (2018/4/25発表から変更なし)



## 当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、1株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

1株当たり配当金は、前期比32%の増配を予定

**TEL**™

**TOKYO ELECTRON**